

股票代號：6552



易華電子股份有限公司
JMC ELECTRONICS CO., LTD

2025/12/10

本簡報中對產業未來的展望為反映本公司截至目前為止的看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。



-Professional Reel-to-Reel Fine-Pitch Service

Confidential

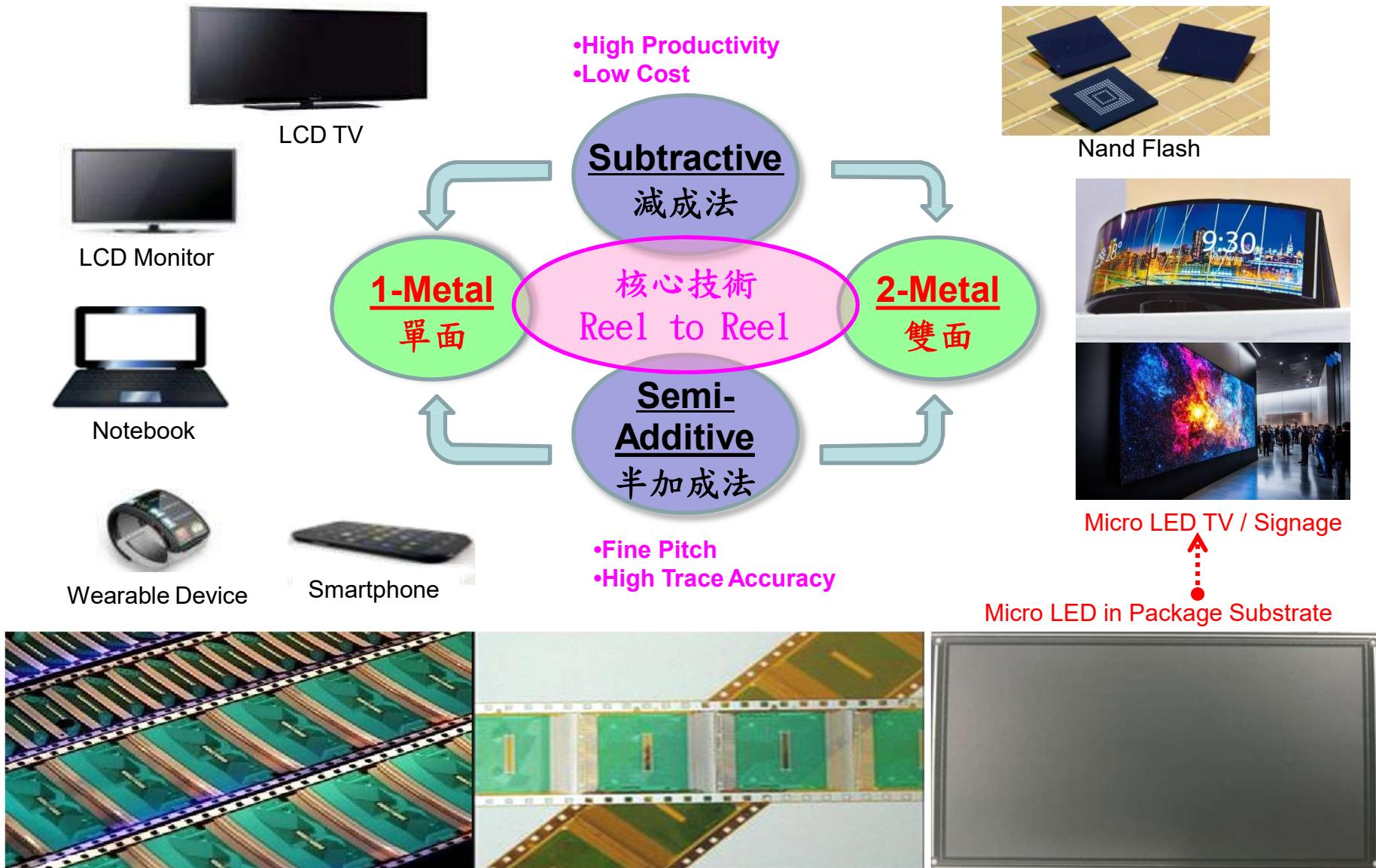


一、公司概況-基本資料

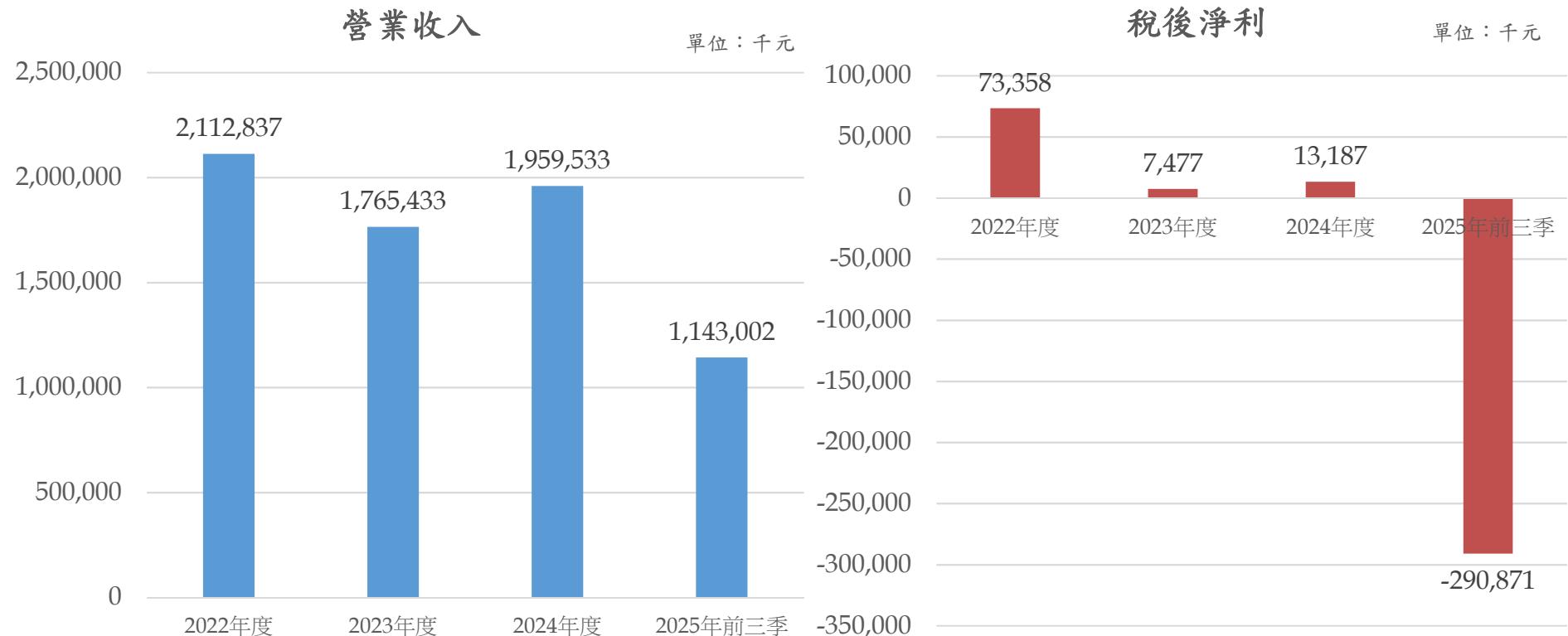
- 公司設立：1973年10月6日(原名台灣住礦電子股份有限公司)
- 董事長：溫文郁
- 總經理：黃梅雪
- 實收資本：新台幣8.3億元
- 主要股東：長華42.8%、南茂10%
- 員工人數：548人(截至2025年11月底)
- 主要產品：捲帶式高階覆晶薄膜IC基板(Reel to Reel Chip on Film)
- 地址：高雄市楠梓區新開發路8號



一、公司概況-產品應用

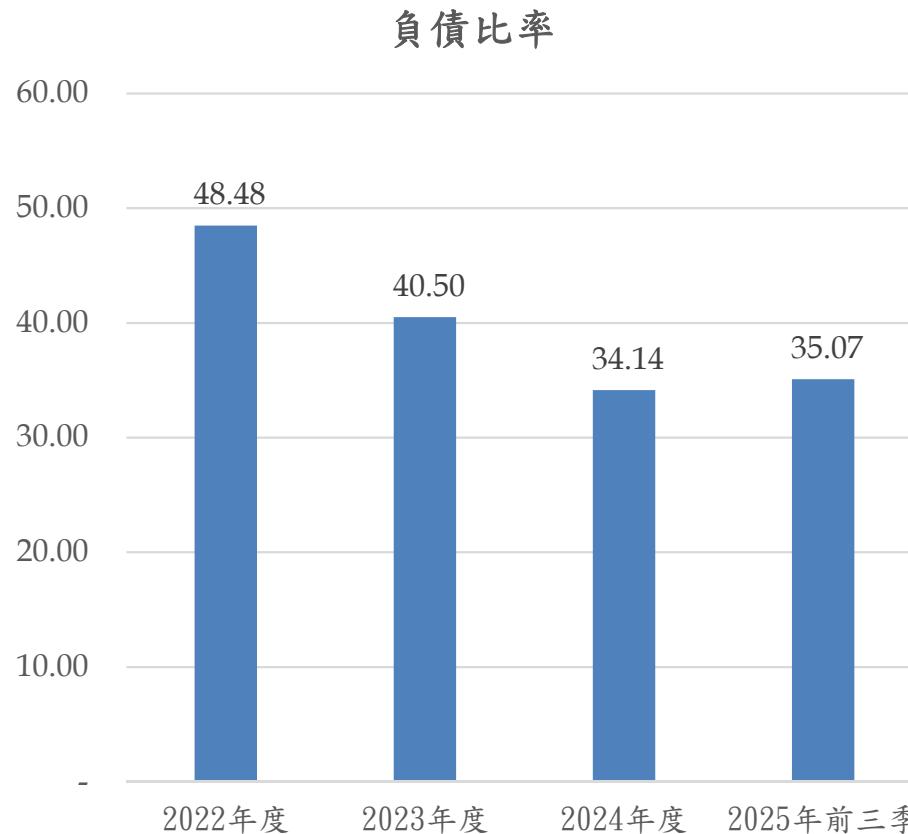


二、營運績效-歷年營收及獲利



年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年前三季
營業收入	2,112,837	1,765,433	1,959,533	1,143,002
稅後淨利	73,358	7,477	13,187	(290,871)

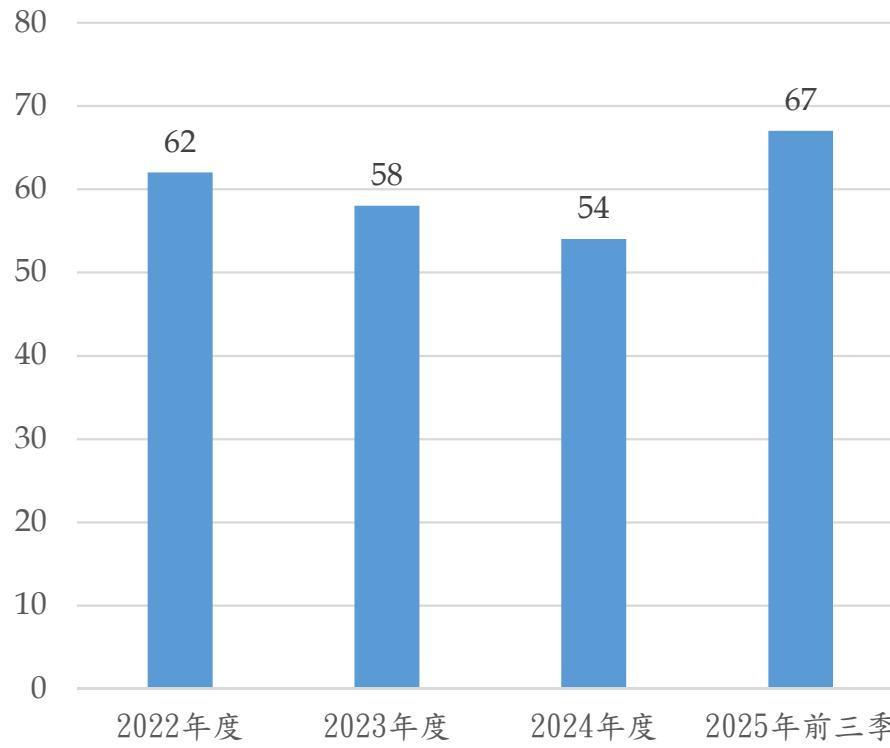
二、營運績效-財務比率分析



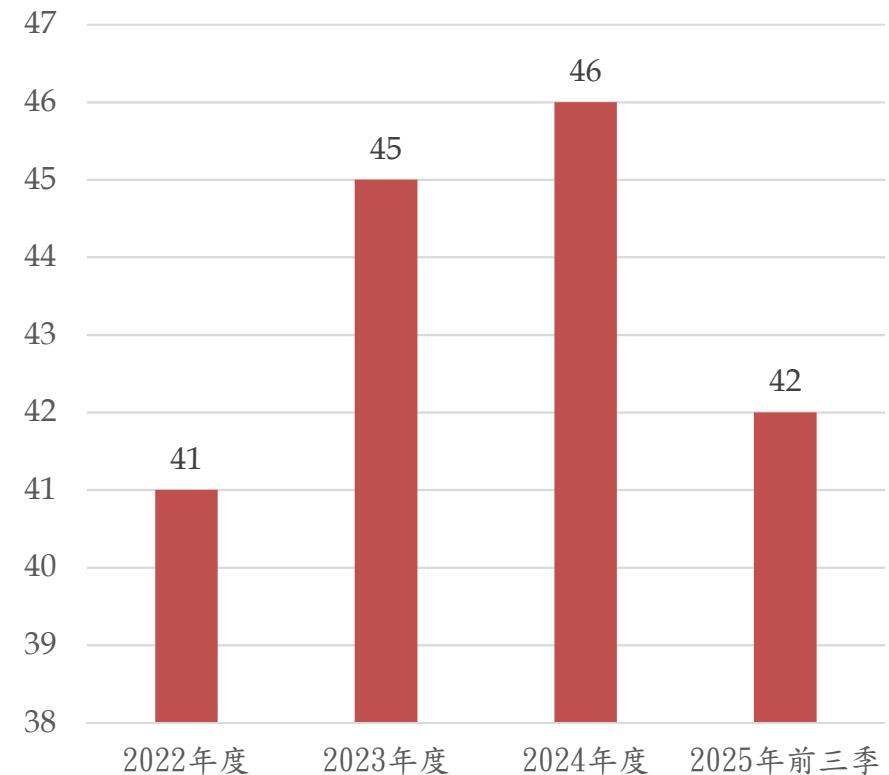
年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年前三季
負債比率	48.48	40.5	34.14	35.07
每股盈餘(元)	0.88	0.09	0.16	(3.50)

二、營運績效-財務比率分析

應收款項週轉天數

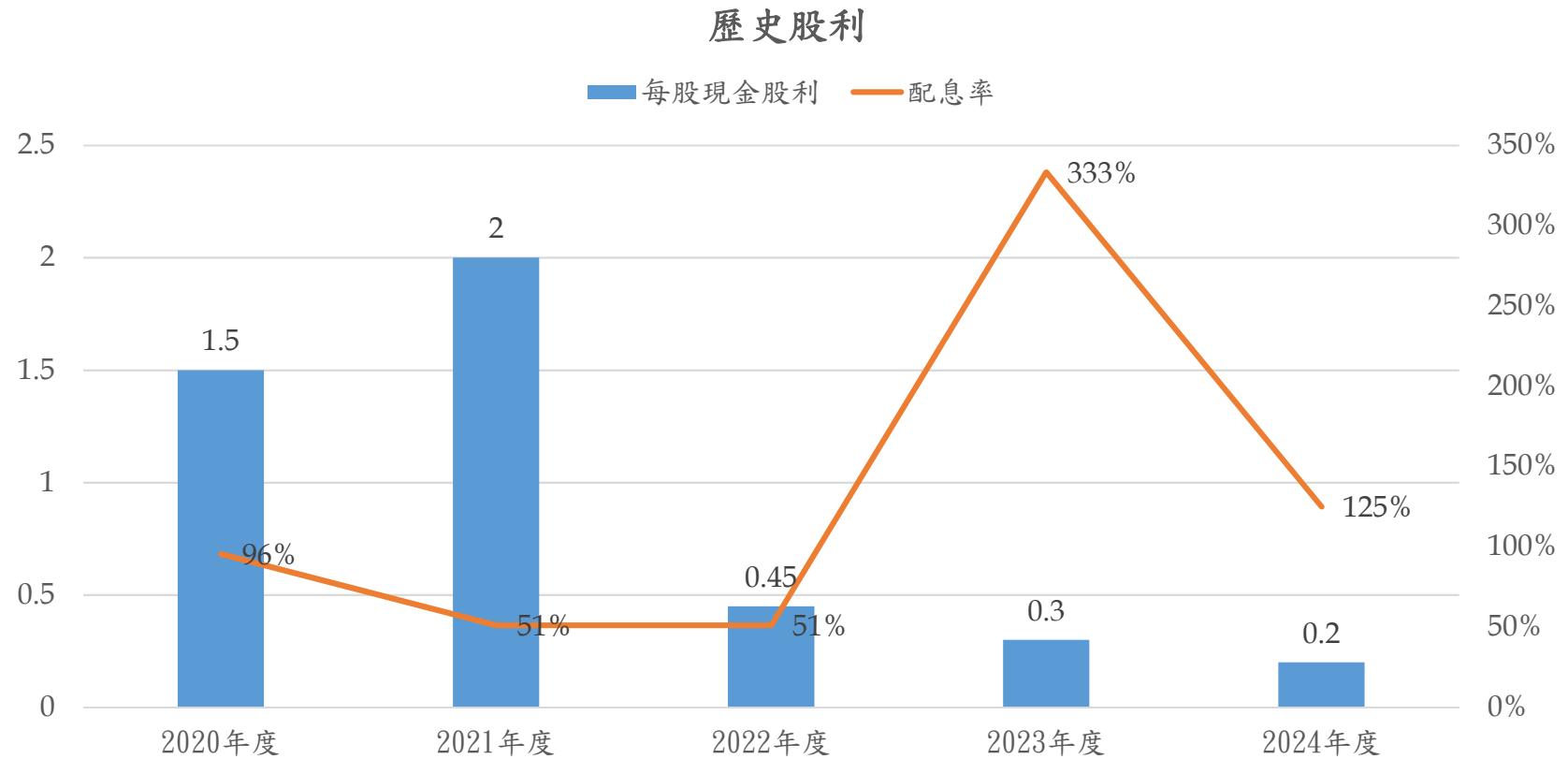


平均銷售天數



年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年前三季
應收帳款週轉天數	62	58	54	67
平均銷售天數	41	45	46	42

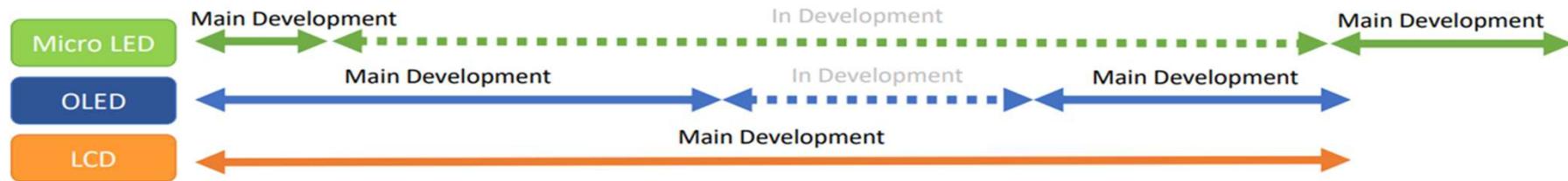
二、營運績效-歷史股利



年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度
每股現金股利	1.5	2	0.45	0.3	0.2
股息率	96%	51%	51%	333%	125%

三、市場狀況與業務展望 - 不同技術的面板開發趨勢

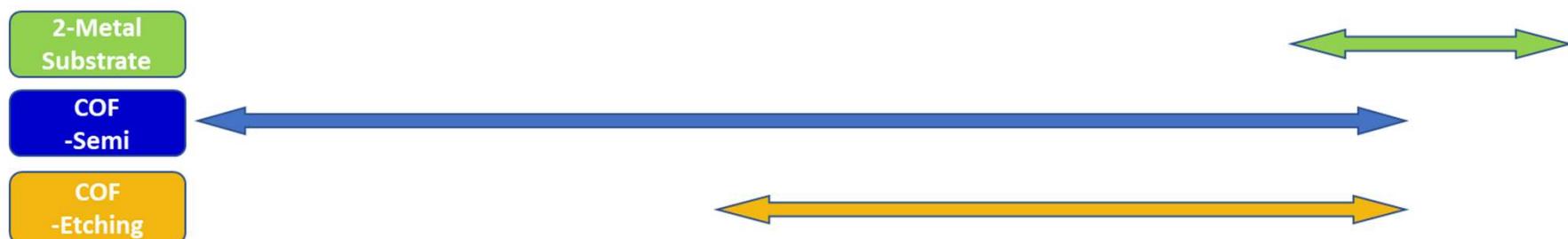
Display technology



Application

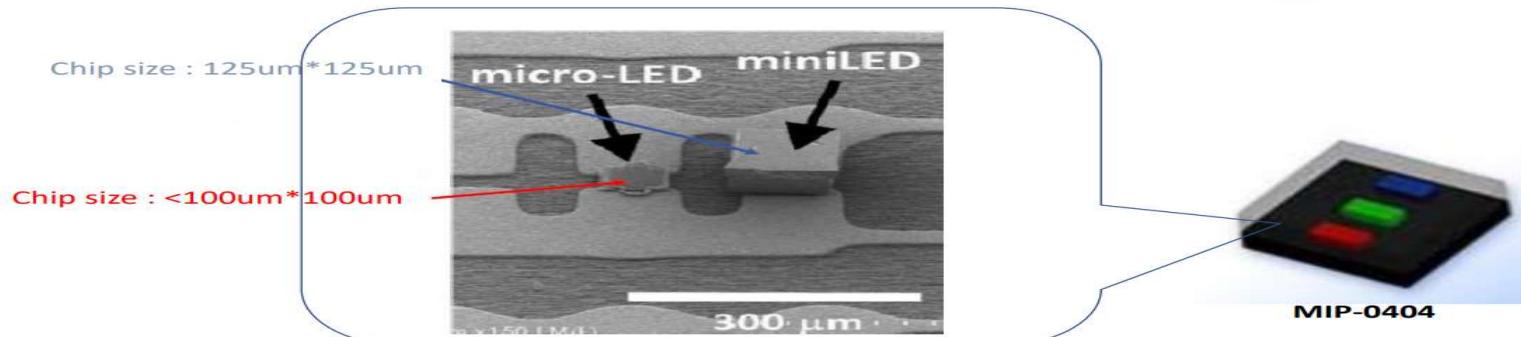


JMC Technology



三、市場狀況與業務展望 - MIP(Micro LED in Package)

1. MIP(Micro LED in Package)結構介紹



- 進入Micro LED產品的微型世界中，微小化的晶片需要高精度及高解析度線路載板進行對應，且配合巨量轉移製程，基板線路的重複性要求極高
- 傳統電路板面臨精度不足，而玻璃/藍寶石基板等生產成本過高，且不適用於MIP的封裝型態，市場上需要介於傳統電路板及玻璃載板之間的高性能載板

2. MIP Substrate製程差異比較

	Reel to Reel Process (JMC)	Panel Process(Other PCB)
Manufacturing Process		
Manufacturing Form		

三、市場狀況與業務展望 - 市場開發

	1-Metal COF	2-Metal IC Substrate
目前	<p>通貨膨脹、全球經濟壓力，影響全球民生需求</p> <ul style="list-style-type: none"> *電視與顯示器 (Monitors)：全球經濟壓力和通膨影響了消費者購買力，導致整體電視和傳統顯示器市場的需求增長趨緩。 *筆記型電腦顯示面板的需求強勁，是拉動大尺寸面板出貨量增長的主要動力之一。對輕薄、窄邊框和柔性螢幕的需求，持續推動COF等先進封裝技術的採用。 *手機面板用驅動IC晶片需求雖然回升，但因為軟性OLED比例上升，COP設計增加，因此COF使用量 持續降低。 *手錶手環兼具健康管理功能成為顯學，COF在此領域用量需求穩定成長。 	<p>LED市場快速擴大，高階需求逐步浮現</p> <ul style="list-style-type: none"> *商用顯示已廣泛導入Mini LED直顯技術，因技術限制，因間隙過大，顆粒感過重，顯示效果仍遠遜於TFT或OLED顯示器。 *現行高階Micro Led直顯屏需使用COG方式進行封裝，為快速將低成本，易華提供Fine Pitch高精度基板，配合客戶巨量轉移技術，實現批量封裝，以大幅Package的成本，有助於加速推動高階直顯LED屏幕導入市場。
未來	<p>散熱、Fine Pitch等高階需求將陸續浮現</p> <ul style="list-style-type: none"> *電視與顯示器 (Monitors)：解析度提升同時，更好的對比及刷新速度，持續推動IC的進步，在散熱需求持續增加。 * Monitor/NB/Tablet面板 – OLED逐步由手機滲透至平板及NB，因應OLED特性，IC將朝向Fine Pitch設計，對高階COF的需求增加。 *車用面板 – 開始COF的設計。 *手機面板-使用COP/COG設計，COF用量減少。 *Wearable面板-穿戴裝置面板由於邊框要求，陸續由COG轉為COF 設計，市場需求穩定成長。 	<p>新設計、新應用…，未來可期</p> <ul style="list-style-type: none"> *2 Metal IC Substrate for Micro LED的應用，因單位成本降低，不僅可以協助客戶開法0.7mm點距以下的Micro LED直顯屏，也有機會以更低的成本來爭取原本Mini LED市場。 *將拓展其他IC Substrate的應用領域。

三、市場狀況與業務展望 - 技術與產品開發

✓ 提供客戶全方位軟性IC substrate產品之供應商

製程	競爭優勢	產品/技術能力	產品應用
1-Metal Sub 減成法	*生產速度快，效率高。 *技術能力自主，生產良率穩定。	*COF 銅厚#~8um 線路>=20um Pitch 腳數=<1440 Channel/48mm	@ TV @ MNT @ NB @Vehicle
1-Metal Semi 半加成法	*高精度尺寸控制的COF產品，可 以提升面板模組組裝良率；協 助客戶降低Total Cost。 *生產良率高及品質穩定性佳， 在生產成本上具有絕對的競爭 優勢。	*COF 銅厚#~12um 線路>=18/16/14um Pitch 腳數=<1900 Channel/48mm =<3000 Channel/70mm	@ TV @ MNT @ NB @Vehicle @ Wearable、Mobile、 Tablet
2-Metal 雙面法	*新製程技術開發能力。 *具備設備設計能力。 *成本控制能力佳。	*Micro LED IC Substrate MIP0404 MIP0303 MIP0202 *Thin Film IC Substrate	@ TV、Signage @ NAND Flash

四、產業概況-驅動IC供應鏈

✓ IC Design House 提供total solution



✓ COF廠分佈區域

製程技術		1-Metal(單面)減成法 Subtractive(Etching)	1-Metal(單面)半加成法 Semi-Additive(Plating)	2-Metal(雙面)
應用	腳數(Channel)/帶寬	=<1400 /48mm	1400~1900 /48mm	1900~2500 /48mm
		=<2000 /70mm	2000~3000 /70mm	3000~4000 /70mm
產能	韓國	S社 90~100KK	X	7-10KK
		L社 120~130KK	X	5-7KK
	日本	F社 20KK	X	2KK
	台灣	C社 70~90KK	X	X
		易華 40KK	40KK	5KK
	大陸	頑材 上達 30KK 30KK	X X	X X

感謝您的聆聽
Thank you for listening

Q&A